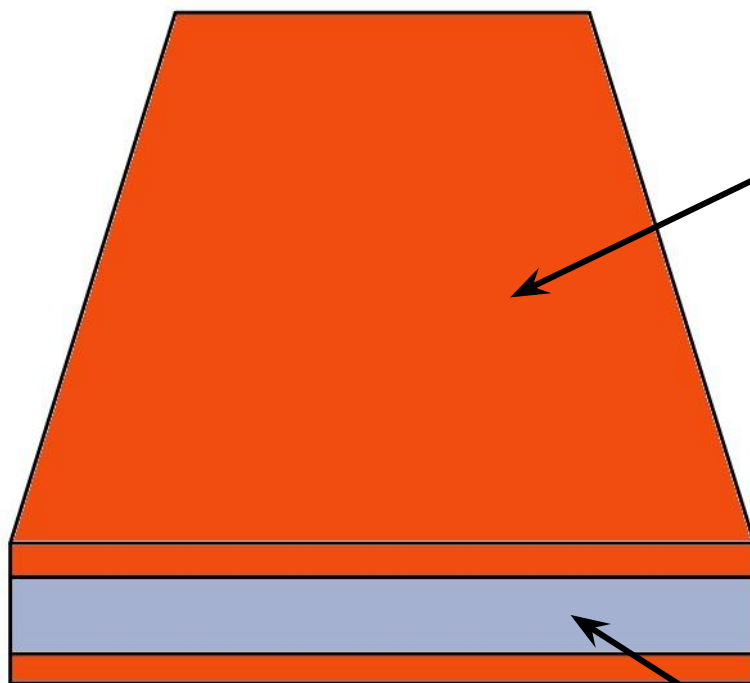


Метод металлизации СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ

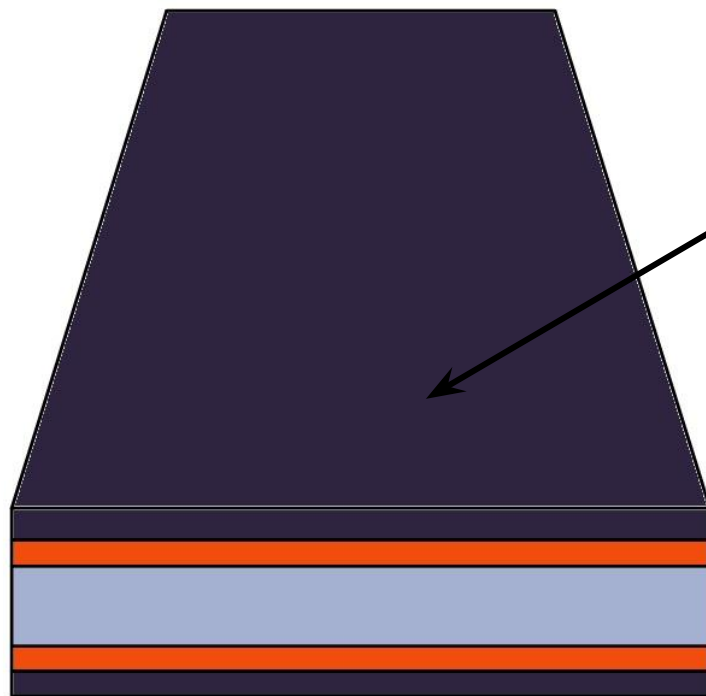
I.



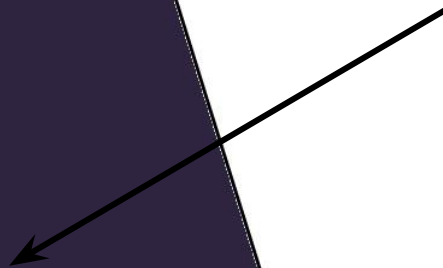
медная
фольга

диэлектрик

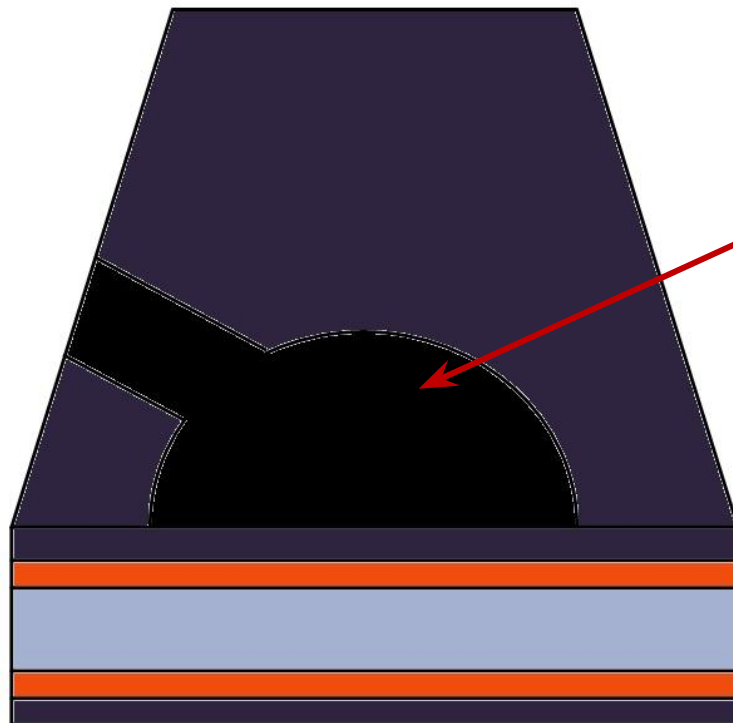
II.



фоторезист



III.

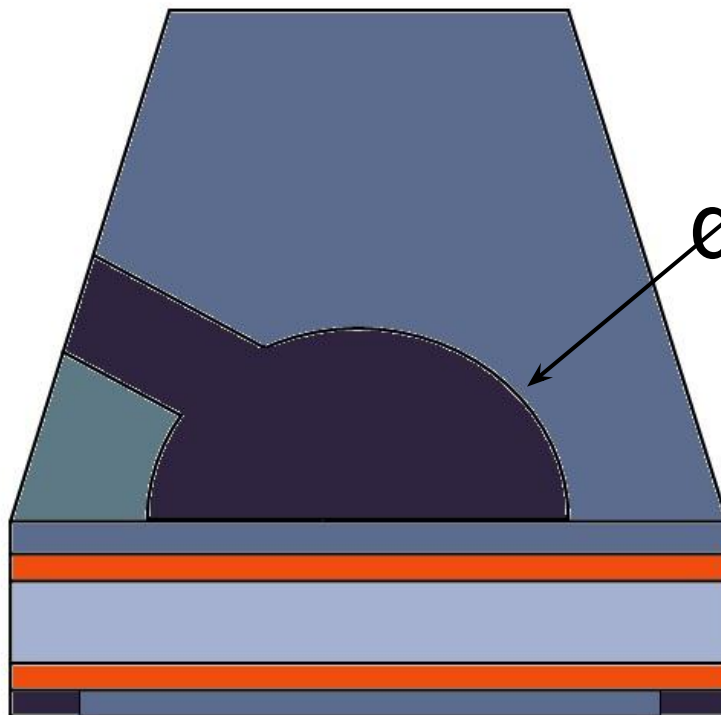


фотошаблон

IV.

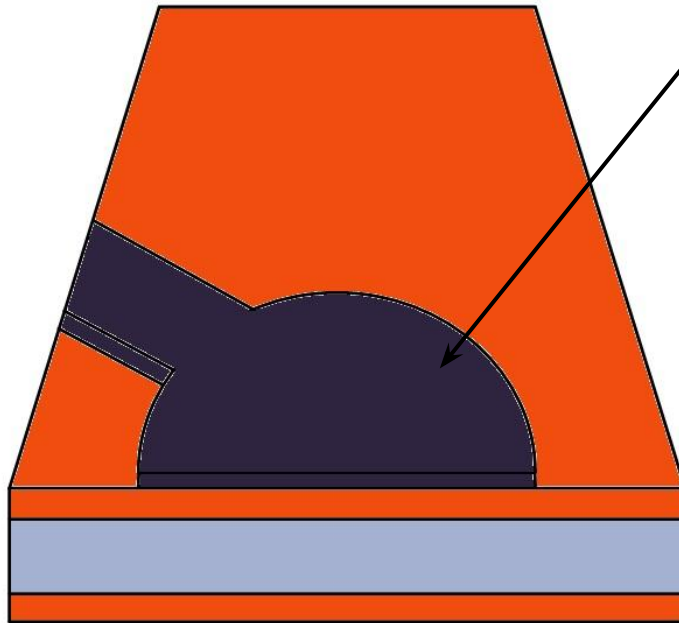
экспонирова
ние

фоторезиста



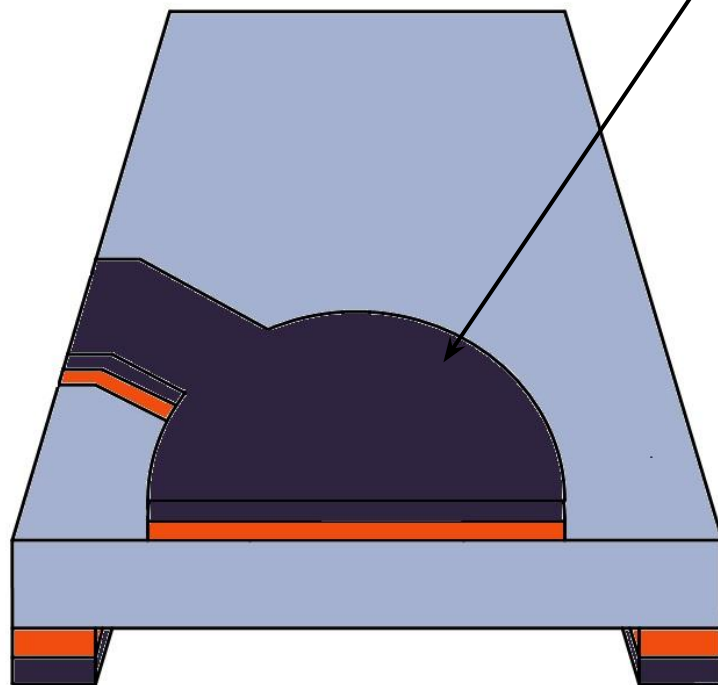
v.

проявление
фоторезиста



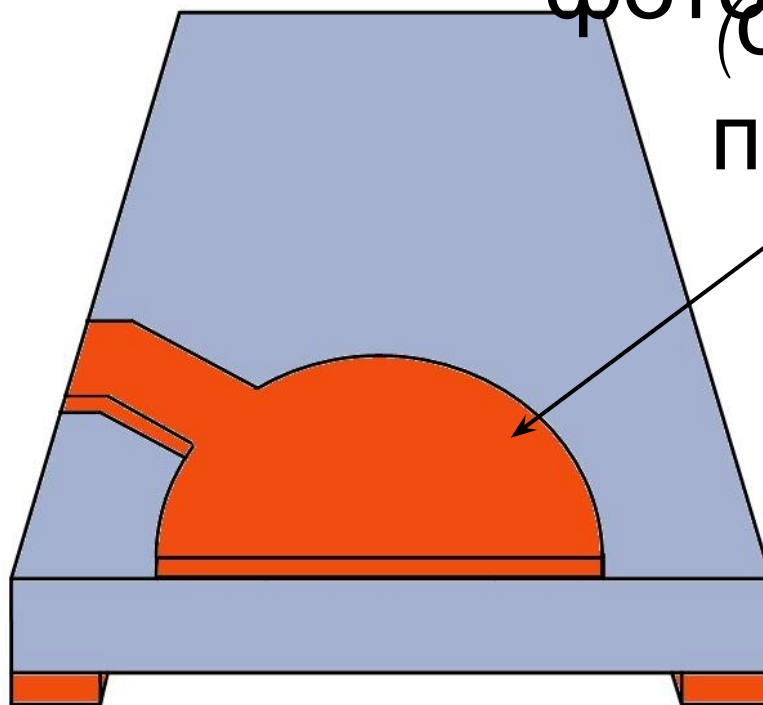
VI.

травление рисунка
схемы



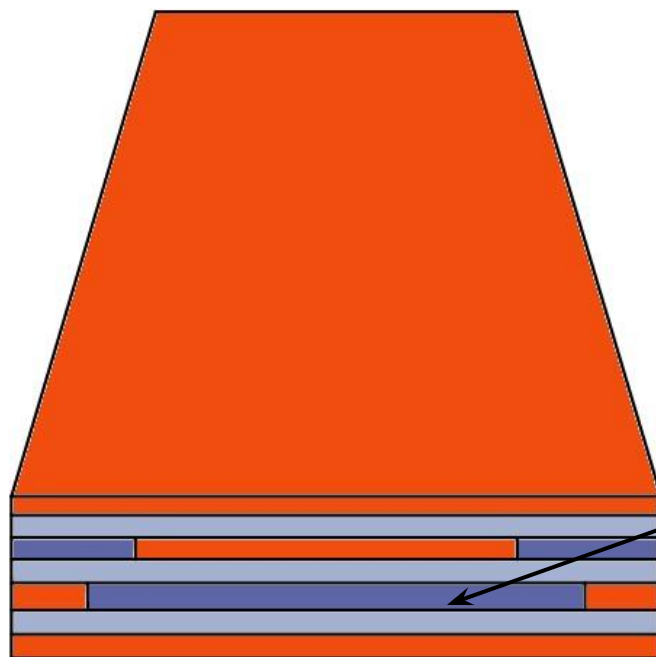
VII.

удаление
фоторезиста
(отриггер-
процесс)



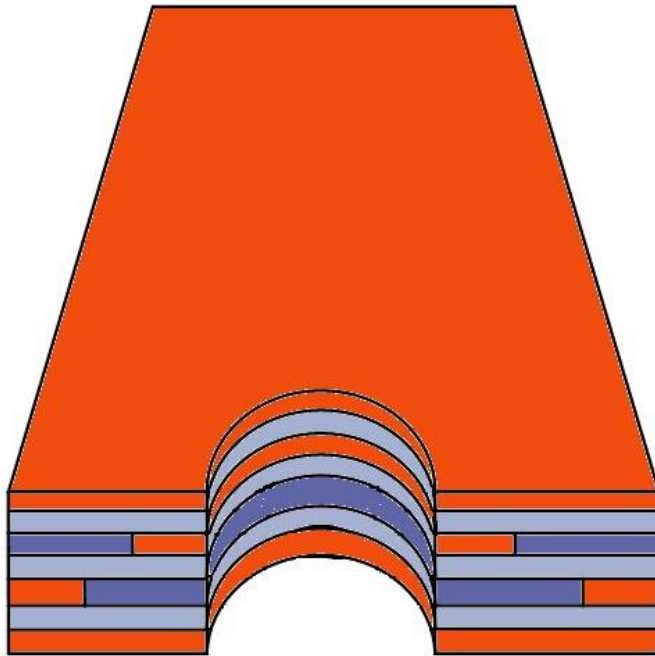
VIII.

прессование слоев
в многослойную
структуру



склеиваю
щие
листы

IX.

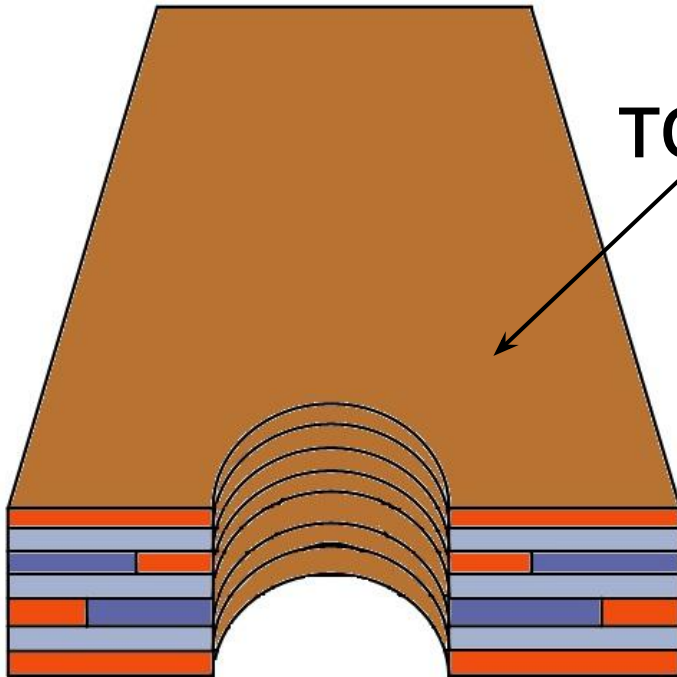


1. сверление
СКВОЗНЫХ
ОТВЕРСТИЙ

2. очистка
отверстий
от наноса смолы
(*Desmear*)

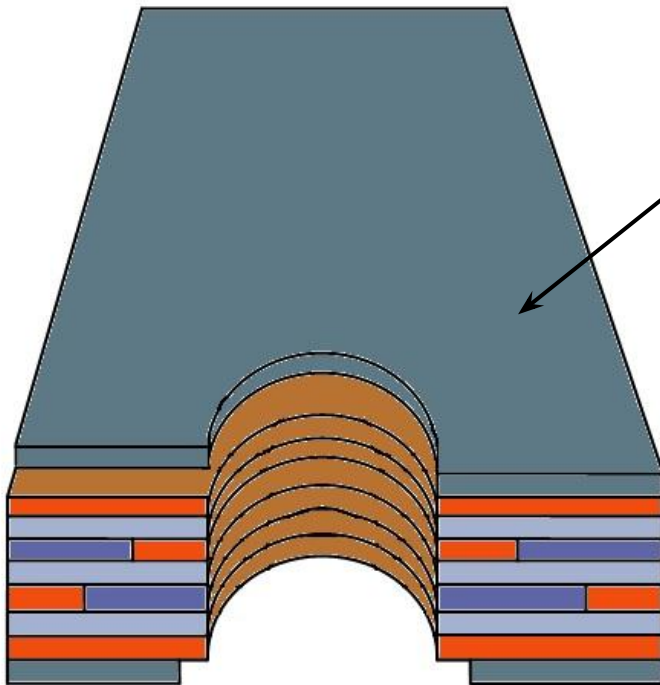
Х.

гальваническое
осаждение
тонкого слоя меди



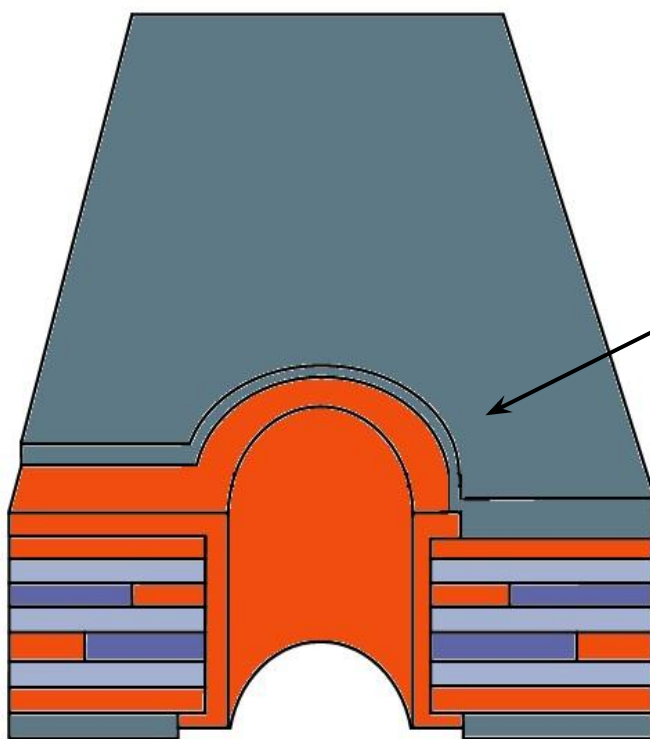
XI.

нанесение
фоторезиста



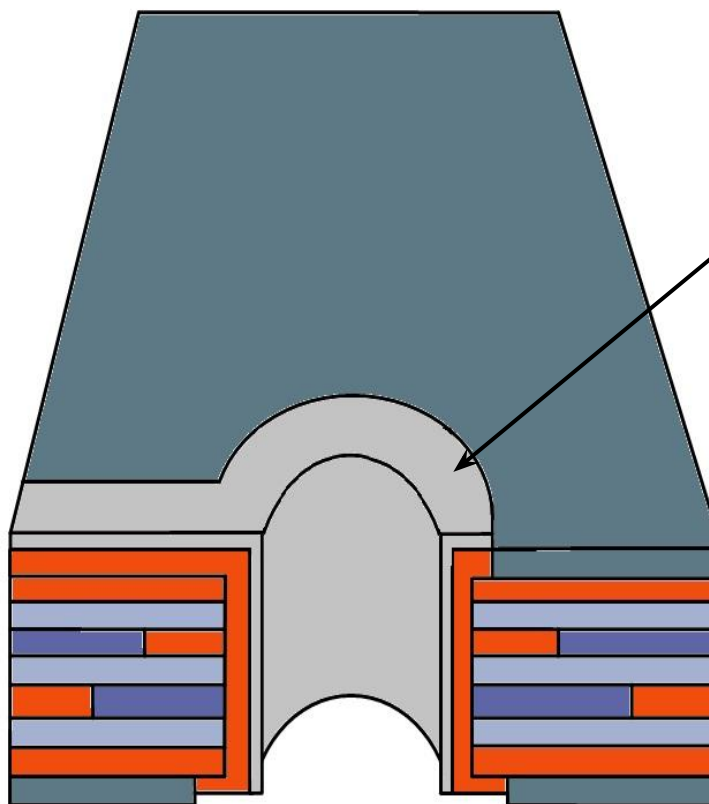
XII.

гальваническое
(электрохимическое)
осаждение меди



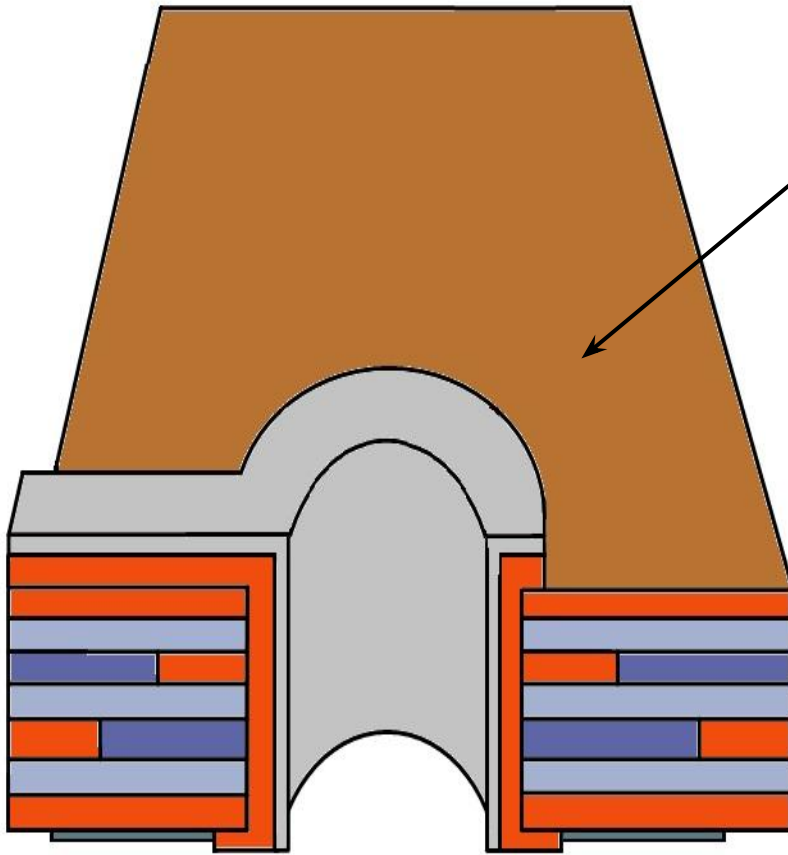
XIII.

гальваническое
осаждение
металлорезиста



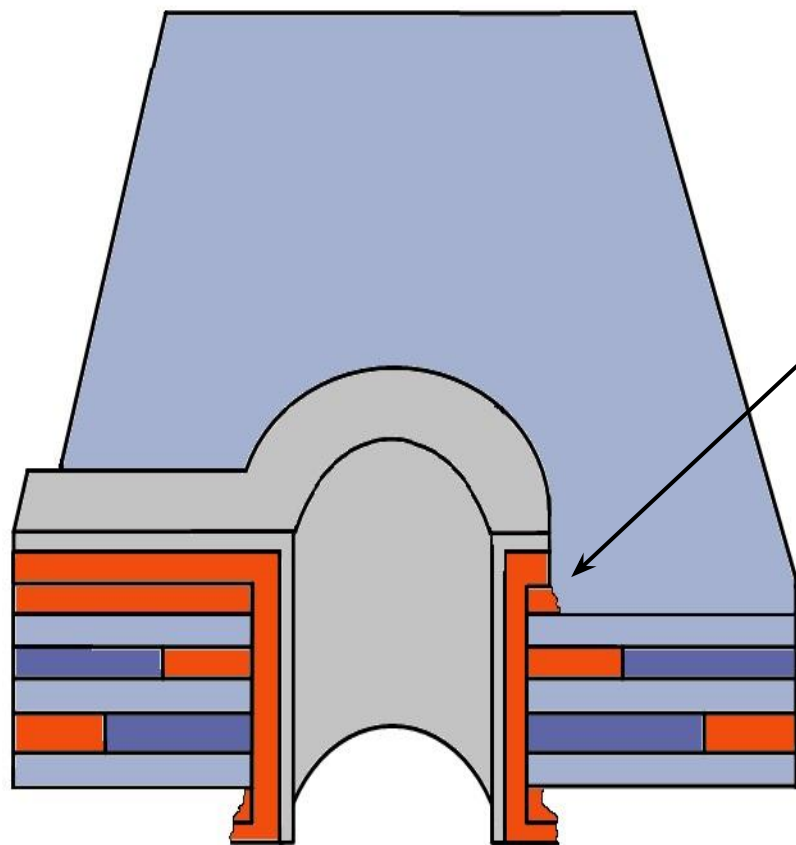
XIV.

удаление
фоторезиста



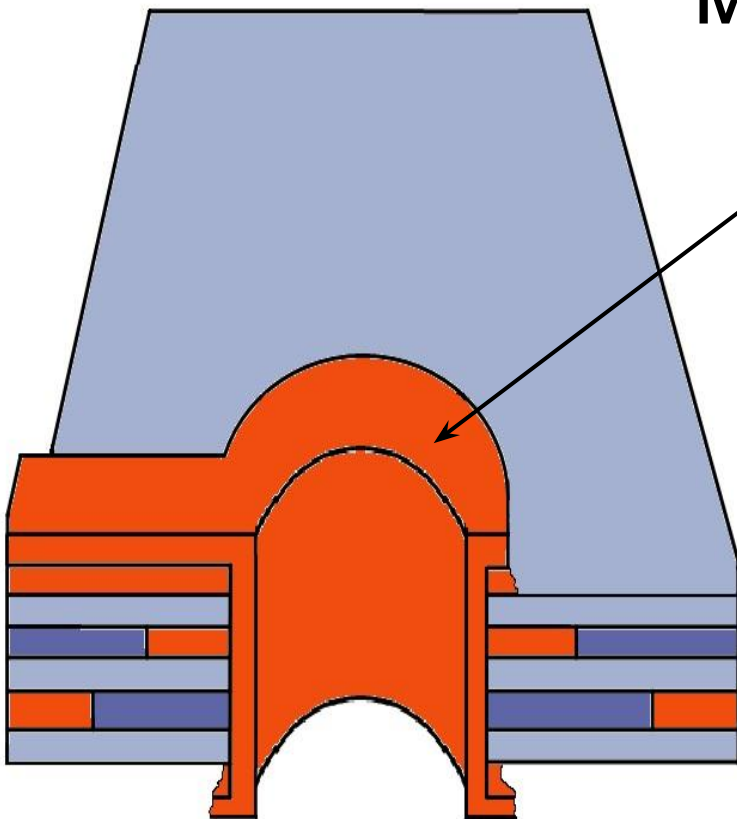
XV.

травление
меди
на внешних
слоях



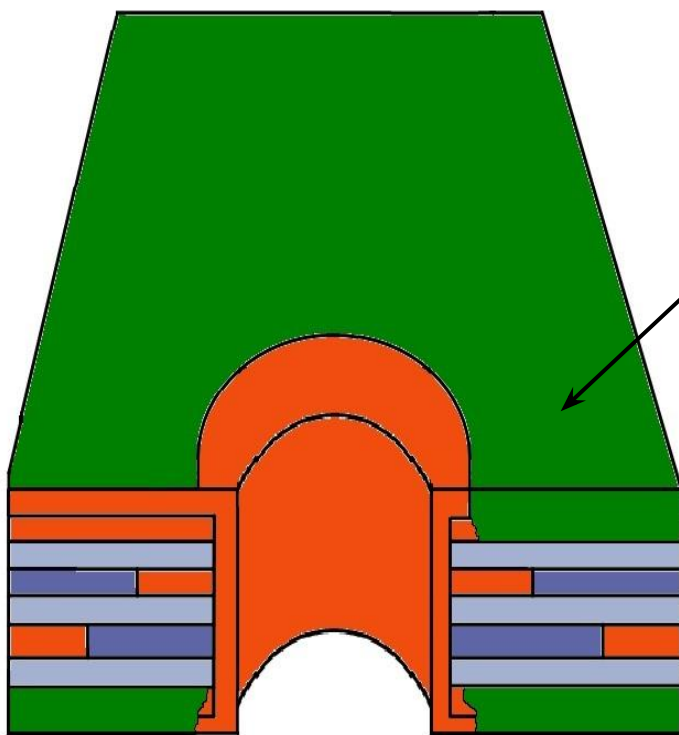
XVI.

удаление
металлорезиста
олово-свинец



XVII.

нанесение паяльной
пасты



XVIII.

обслуживание
МОНТАЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

